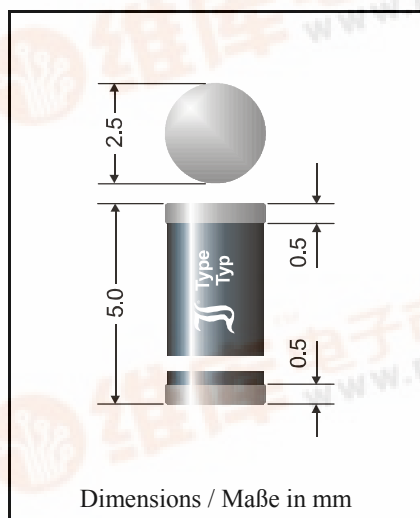


Surface Mount Schottky-Rectifiers**Schottky-Gleichrichter
für die Oberflächenmontage**

Nominal current – Nennstrom 3 A

Repetitive peak reverse voltage 20...100 V

Periodische Spitzensperrspannung

Plastic case MELF DO-213AB

Kunststoffgehäuse MELF

Weight approx. – Gewicht ca. 0.12 g

Plastic material has UL classification 94V-0

Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert

Standard packaging taped and reeled see page 18

Standard Lieferform gegurtet auf Rolle siehe Seite 18

Maximum ratings**Grenzwerte**

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspg. V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]	Forward voltage Durchlaßspannung V_F [V] ¹⁾
SMS 320	20	20	< 0.50
SMS 330	30	30	< 0.50
SMS 340	40	40	< 0.50
SMS 350	50	50	< 0.70
SMS 360	60	60	< 0.70
SMS 390	90	90	< 0.79
SMS 3100	100	100	< 0.79

Max. average forward rectified current, R-load
Dauergrenzstrom in Einwertschaltung mit R-Last $T_T = 100^\circ\text{C}$ I_{FAV} 3 ARepetitive peak forward current
Periodischer Spitzenstrom $f > 15\text{ Hz}$ I_{FRM} 12 A ²⁾Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwellen $T_A = 25^\circ\text{C}$ I_{FSM} 50 ARating for fusing, $t < 10\text{ ms}$
Grenzlastintegral, $t < 10\text{ ms}$ $T_A = 25^\circ\text{C}$ i^2t 12.5 A²s¹⁾ $I_F = 3\text{ A}$, $T_A = 25^\circ\text{C}$ ²⁾ Max. temperature of the terminals $T_T = 100^\circ\text{C}$ – Max. Temperatur der Anschlüsse $T_T = 100^\circ\text{C}$

Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur

T_j – 50...+150°C
 T_s – 50...+150°C

Characteristics

Kennwerte

Leakage current – Sperrstrom

$T_j = 25^\circ\text{C}$
 $T_j = 100^\circ\text{C}$

$V_R = V_{RRM}$
 $V_R = V_{RRM}$

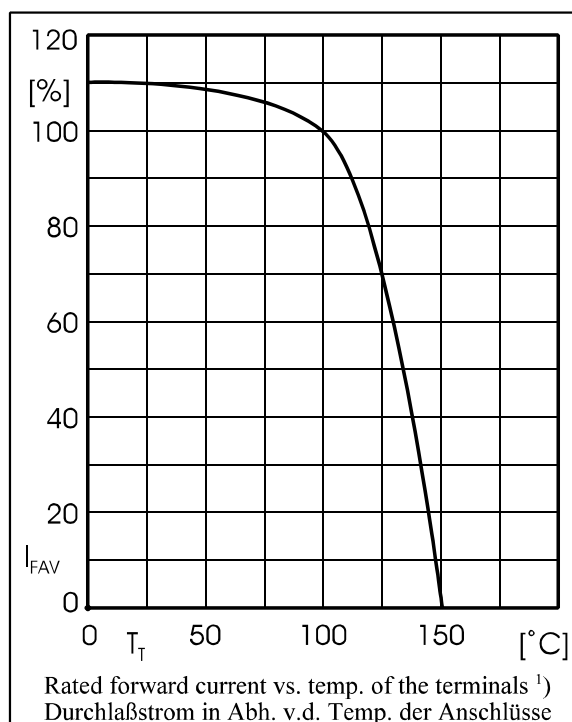
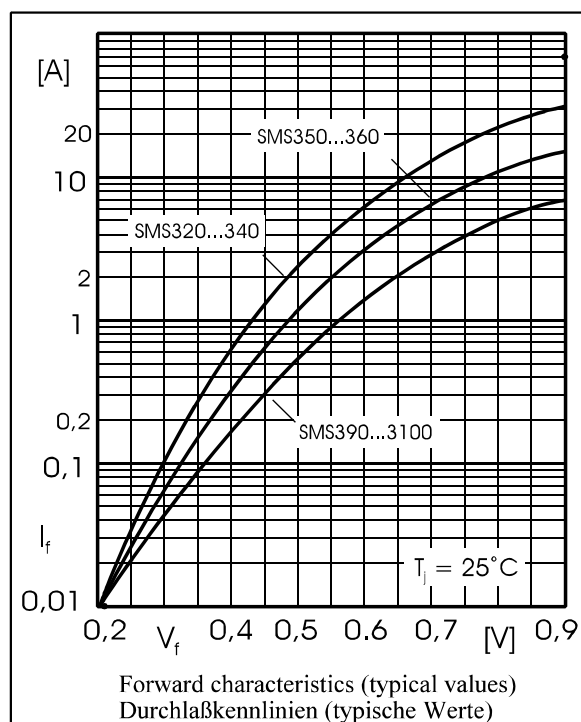
I_R < 0.5 mA
 I_R < 10.0 mA

Thermal resistance junction to ambient air
Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft

R_{thA} < 45 K/W ¹⁾

Thermal resistance junction to terminal
Wärmewiderstand Sperrschicht – Kontaktfläche

R_{thT} < 10 K/W



¹⁾ Mounted on P.C. board with 50 mm² copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 50 mm² Kupferbelag (Lötnad) an jedem Anschluß